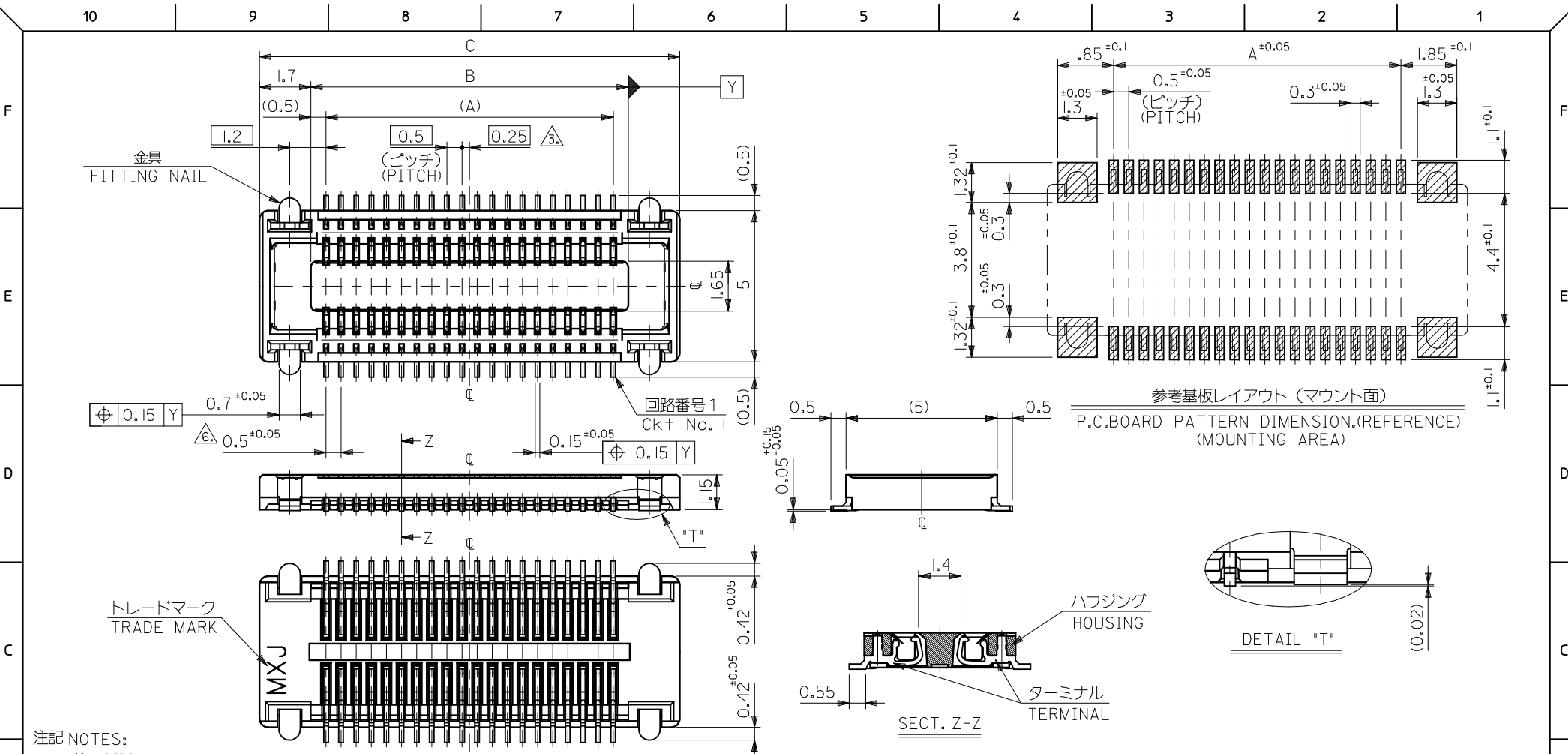




注記 NOTES:

1. 使用材料 MATERIAL
ハウジング: ポリフェニレンサルファイド ガラス充填
UL94V-0 (黒)
HOUSING: POLYPHENYLENE SULFIDE (GLASS FILLED) UL94V-0 (COLOR: BLACK)
ターミナル: リン青銅 (t=0.15)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)
金具: リン青銅 (t=0.2)
FITTING NAIL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.2)

2. メッキ仕様 PLATING
ターミナル TERMINAL
金メッキ 0.25 マイクロメートル以上 (コンタクト部)
GOLD 0.25 MICROMETER MINIMUM (CONTACT AREA)
金メッキ 0.4 マイクロメートル以下 (テール部)
GOLD 0.4 MICROMETER MAXIMUM (TAIL AREA)
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.5 マイクロメートル以上
UNDER PLATING: NICKEL 1.5 MICROMETER MINIMUM
金具 FITTING NAIL
半田メッキ 3.0 マイクロメートル以上 TIN-LEAD 3.0 MICROMETER MINIMUM
下地メッキ: 銅メッキ 1.0 マイクロメートル以上 COPPER 1.0 MICROMETER MINIMUM

3. (全極数/2) = 偶数の場合に適用。
APPLY FOR (CIRCUIT/2) = EVEN.

4. 嵌合相手: 53929 シリーズ
MATE WITH: 53929 SERIES.
5. テール平坦度は、0.08MAX. テール及び金具の平坦度は、0.1MAX.
TAIL COPLANARITY TO BE 0.08MAX. TAIL AND FITTING NAIL COPLANARITY TO BE 0.1MAX.
6. テール部に適用。
APPLY TO THE TAIL AREA.

28.9	25.5	24.5	54137-100I	100
23.9	20.5	19.5	54137-080I	80
C	B	A	MATERIAL NO.	極数 CIRCUIT

MODEL NO. 54137-***1

REVISED EC NO: J2009-04/50 DRWN: NAKAMURA 2008/11/26 CHKD: T. HARUYAMA 2008/11/26 APPR: NUKITA 2009/01/08 B	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	±0.2	DRAWN BY H. SHIMOYAMA	DATE '97/10/8	TITLE 0.5 B-TO-B CONN REC ASSY (HGT=1.5MM) WITH NAIL				
		10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY M. FUKUSHIMA	DATE '00/6/22					
		30 OVER	±0.3	APPROVED BY M. FUKUSHIMA	DATE '00/6/22	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ±3 °	MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.					
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-54137-003		1 OF 1		
	REV			SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				